

ELEGRIP® TAPE

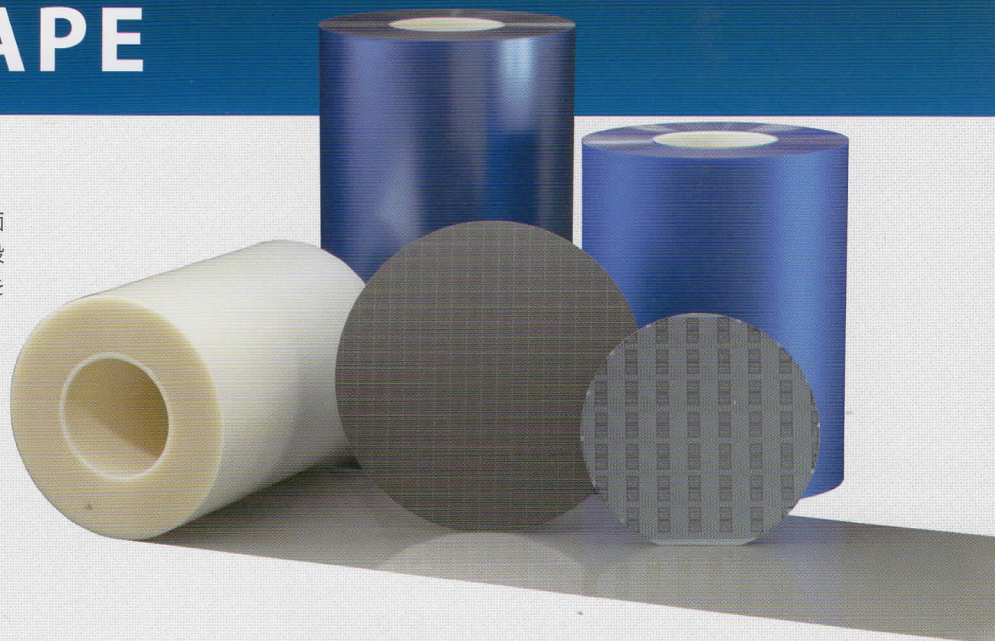
概要

バックグラインドテープは、ウエハ裏面の研削時に回路面を保護するテープです。洗浄工程を必要としない粘着剤設計をコンセプトに、低パーティクル性や安定した研削性を兼ね備えています。

Overview

Back grinding tapes protect the surface of wafer circuits and prevent them from becoming damaged during back grinding.

Featuring an adhesive agent that eliminates the need for cleaning, ELEGRIP® tapes ensure low particle count and stable grinding performance.



バックグラインドテープ

Back Grinding Tape

● 特長

- ウエハ回路面の凹凸に対する優れた密着性
- バックグラインド時の安定した研削性（低TTV※1）
- 安定した低パーティクル特性を実現する事で、洗浄工程が不要
- 粘着力の経時変化が小さく、はく離性が安定

※1 TTV Total Thickness Variation

● Features

- Exhibits superior adhesive qualities on roughness of patterned surfaces
- Ensures stable grinding performance during back grinding (Low TTV*1)
- Delivers stable low particle count performance, eliminating the need for cleaning
- Exhibits stable adhesive strength, unaffected by storage time

*1 TTV=Total Thickness Variation

一般物性 / Physical Properties

品種 Product number	基材 Base Film	色相 Color	総厚 Total Thickness (μm)	粘着剤厚 Adhesive Thickness (μm)	粘着力 Adhesive Strength (N/20mm)	プローブタック Probe Tack (N/20mm ²)	備考 Remarks
BGE-122S	EVA	LB	140	20	1.30	1.19	標準タイプ Standard types
BGE-122V					1.59	1.72	
BGE-1240A6			160	40	0.31	1.87	凹凸有りウエハ研削用 For middle-bumped wafers
BGE-124S					1.41	1.29	
BNY-1250A3			170	50	1.59	3.21	
BNY-1250A4					1.23	2.58	
P- Series	PET	T	85	35	18.04	13.97	BGテープ剥がし用(はく離ライナーなし) For detaping back grinding tape (release linerless)

備考 / 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
色相: LB(ライトブルー)、T(透明)
はく離ライナーの厚さは含まれておりません。

Notes: The above-mentioned values are representative values only, and are not guaranteed.
Colors: LB=light blue, T=transparent
The thickness of the release liner is not included.

Q. エレグリップの基材の材質は何ですか?
What kinds of base films do you have?

A. エレグリップの基材は、塩化ビニル(PVC)、ポリオレフィン(PO)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、エチレンビニルアセテート(EVA)があります。
We have 4 types. Polyvinyl chloride (PVC), polyolefin (PO), polyethylene terephthalate (PET), and ethylene vinyl acetate (EVA).

Q. テープ選定に必要な情報は何か?
What kind of information is needed to choose suitable tapes?

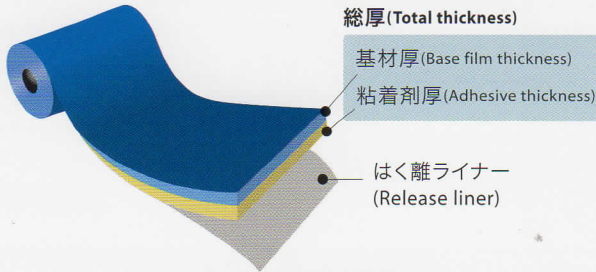
A. ワークやワーク表面の材質、サイズ、加工条件などです。それらを考慮した上で、課題や問題点を解決できる品種を選定いたします。
We suggest the tape that fits your needs and applications, regarding surface material and size of the workpiece, and processing conditions.

参考資料：粘着テープ性能表示・試験方法

Reference: How to identify and test the properties of adhesive tapes

総厚

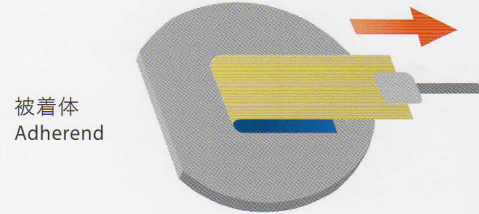
Total Thickness



総厚 = 基材厚 + 粘着剤厚
はく離ライナー (PET: 38 μ m) の厚さは含まない
Total thickness = Base Film Thickness + Adhesive Thickness
Release liner (PET: 38 μ m) is not included.

粘着力

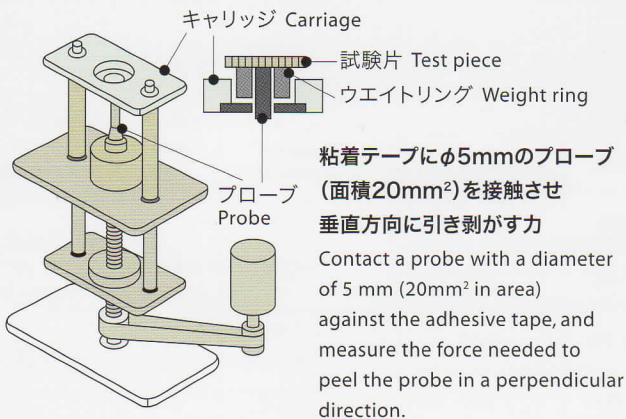
Adhesive Strength



被着体に短冊状テープを圧着させ、
180度方向に引き剥がす力
Press strip of tape to an adherend
and then measure the force of 180 degree peel.

プローブタック

Probe Tack



引っ張り強さ

Tensile Strength

間隔を100mmにしたテープの両端を引っ張り、
テープ切断時に荷重する力
Pull both ends of a 100 mm-long tape outward,
and then measure the force applied when the tape is cut.



伸び

Elongation

テープの両端を引っ張り、測定される伸び率
The degree of elongation, measured when
both ends of the tape are pulled outward.



Q

プローブタックとは何ですか？
What is probe tack?

A. プローブタックとは、プローブを瞬間的に粘着テープに接触させて、引き剥がす時の強度を測定する方法で、粘着表面のべたつきを評価する方法の一つです。

Probe tack is a method for measuring the stickiness of the adhesive surface. Contact the probe against the adhesive tape for a second, and then measure the force needed to remove the probe from the tape.